

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成24年12月13日 (2012.12.13)

【公表番号】特表2012-507609(P2012-507609A)

【公表日】平成24年3月29日 (2012.3.29)

【年通号数】公開・登録公報2012-013

【出願番号】特願2011-534778(P2011-534778)

【国際特許分類】

C 0 8 J 7/04 (2006.01)

C 0 9 J 183/04 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

C 0 9 K 3/00 (2006.01)

B 0 5 D 3/06 (2006.01)

B 0 5 D 5/00 (2006.01)

B 0 5 D 7/24 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 J 7/04 C E R M

C 0 8 J 7/04 C E Z

C 0 9 J 183/04

C 0 9 J 7/02 Z

C 0 9 K 3/00 R

B 0 5 D 3/06 1 0 1 Z

B 0 5 D 5/00 A

B 0 5 D 7/24 3 0 2 Y

【手続補正書】

【提出日】平成24年10月26日 (2012.10.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

シリコーン剥離層を作製する方法であって、1つ以上のポリシロキサン物質を基材上に含む組成物を塗布することと、前記組成物を電子線硬化して前記ポリシロキサン物質を架橋させることと、を含み、前記ポリシロキサン物質が非官能性のポリシロキサン、シラノールで終端されたポリシロキサン、及びアルコキシで終端されたポリシロキサンよりなる群から選択される、方法。

【請求項 2】

請求項 1 に従って作製された、剥離剤コーティング基材。